2026年3月期
第2四半期決算説明資料

2025年11月7日

Click here for the English Ver

TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

主な説明内容

1．2026年3月期　上期実績

2．2026年3月期　通期予想

主な説明内容

1．2026年3月期　上期実績

2．2026年3月期　通期予想

2026年3月期　上期サマリー

受注高	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
250.3 億円	234.4 億円	24.9 億円	23.9 億円	18.4 億円
（前年同期比 ▲0.8%）	（前年同期比 ▲14.4%）	（前年同期比 ▲52.6%）	（前年同期比 ▲54.2%）	（前年同期比 ▲51.7%）
（予想比 +4.3%）	（予想比 +2.0%）	（予想比 +45.8%）	（予想比 +40.0%）	（予想比 +54.2%）

受注高

・第1四半期で底打ちし、第2四半期はAI・データセンター向けやメモリ向けを中心に回復。
・第2四半期の受注高は146.1億円となり、下期も堅調な推移を見込む。

売上高

・米国関税の影響で顧客の投資判断が慎重となり、第1四半期が低調となった結果、前年同期比で減収。
・第2四半期の売上高は153.7億円となり、四半期ベースでは過去2番目の高水準を記録。

利益

・売上高の減少に伴い、対前年同期比では減益。
・コンプレッション売上の増加など製品ミックスの改善により、各段階利益は予想を上回る水準で着地。

TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

2026年3月期上期決算のサマリーです。

受注高は前年度後半から低調な推移が続いていましたが、第1四半期で底打ちし、第2四半期にはAI・データセンター向けやメモリ向けを中心に回復傾向が見られました。
第2四半期の受注高は146.1億円となり、下期も堅調な推移を見込んでおります。

売上高は、米国関税の影響でお客様の投資判断が慎重となり、第1四半期が低調となった結果、前年同期比では減収となりました。
一方、第2四半期の売上高は153.7億円となり、四半期ベースでは過去2番目の高水準を記録しました。

利益面では、売上高の減少に伴い、各段階利益は前年同期比で減益となりました。
一方、コンプレッション装置・金型の売上増加に伴う製品ミックスの改善などの効果により、各段階利益は当初予想を上回る水準で着地しました。

2026年3月期 上期連結業績結果

（単位：億円）

	25/3期 上期実績	26/3期 上期実績	前年比	26/3期 上期予想	予想比
売　上　高	273.9	234.4	▲ 39.4 (▲ 14.4%)	230.0	+ 4.4 (+ 2.0%)
営 業 利 益	52.6	24.9	▲ 27.6 (▲ 52.6%)	17.1	+ 7.8 (+ 45.8%)
営業利益率	19.2%	10.6%	▲ 8.6pt	7.4%	+ 3.2pt
経 常 利 益	52.2	23.9	▲ 28.3 (▲ 54.2%)	17.1	+ 6.8 (+ 40.0%)
当期純利益	38.2	18.4	▲ 19.7 (▲ 51.7%)	12.0	+ 6.4 (+ 54.2%)

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

こちらは上期の業績結果です。

売上高は、米国の関税政策の影響などにより、前期下期から受注が低迷しました。
その結果、第1四半期の売上高が大きく落ち込み、上期累計では前年同期比14.4%減となりました。

利益についても、売上高の減少に伴い、各段階で前年同期比減益となりました。
一方で、コンプレッション装置や金型の売上増加による製品ミックスの改善などが寄与し、利益は予想を上回る水準で着地しました。

詳細については、10ページの増減要因分析をご覧ください。

2026年3月期 上期セグメント別売上高

（単位：億円）

	25/3期 上期実績	26/3期 上期実績	前年比	26/3期 上期予想	予想比
売上高	273.9	234.4	▲39.4 (▲ 14.4%)	230.0	+4.4 (+ 2.0%)
半導体事業	207.4	173.3	▲34.2 (▲ 16.5%)	165.8	+ 7.5 (+ 4.5%)
メディカルデバイス事業	11.3	12.2	+1.0 (+ 8.4%)	11.9	+ 0.3 (+ 2.5%)
新事業	45.7	42.6	▲3.1 (▲ 6.8%)	45.5	▲ 2.9 (▲ 6.4%)
レーザ事業	9.5	6.4	▲3.1 (▲ 33.0%)	6.8	▲ 0.4 (▲ 5.3%)

TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

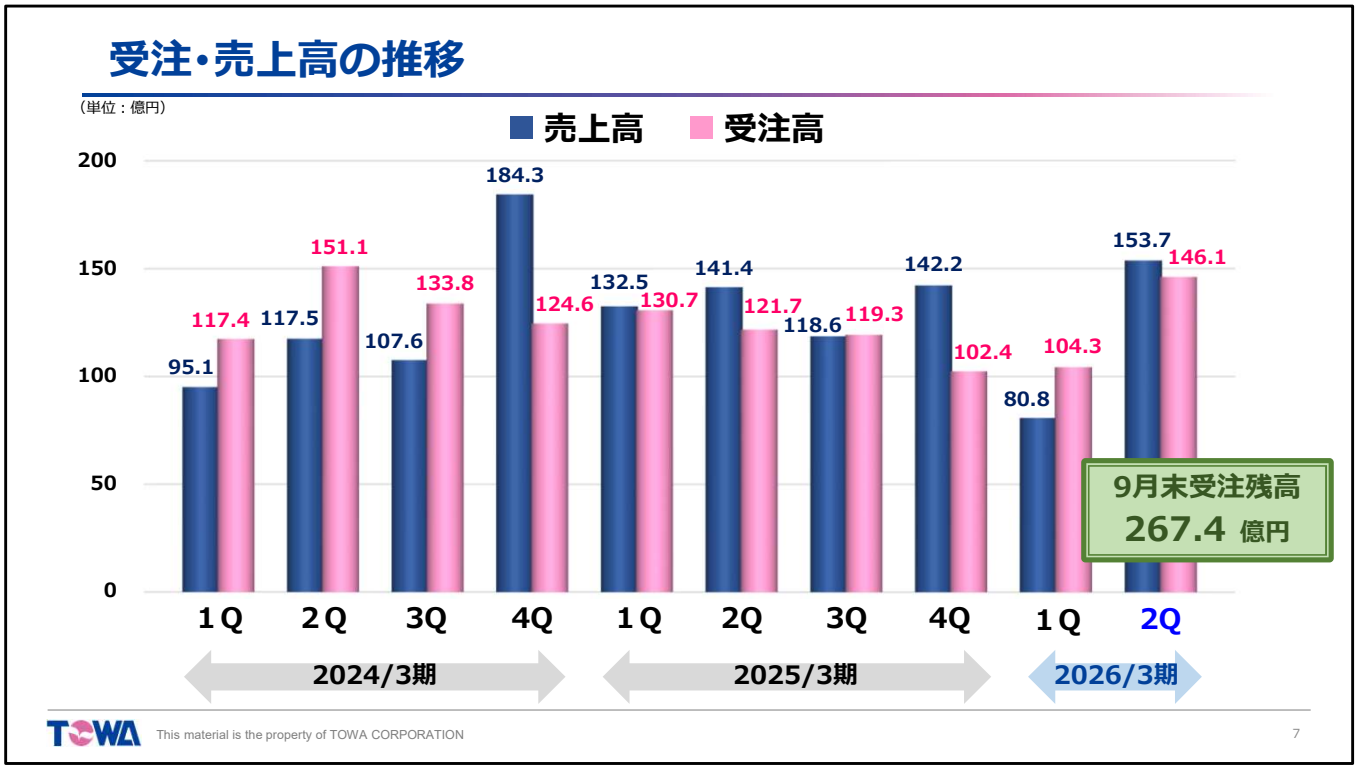
こちらはセグメント別の売上高です。

半導体事業につきましては、前年度後半から続く米国関税政策の影響により、お客様の投資判断が慎重となっていたことから、前期比で16.5%減となりました。

メディカルデバイス事業につきましては、医療用成形品や組立品の需要が堅調に推移し、前期比で8.4%増となりました。

新事業につきましては、半導体設備投資動向に連動し、前期比6.8%減となりました。

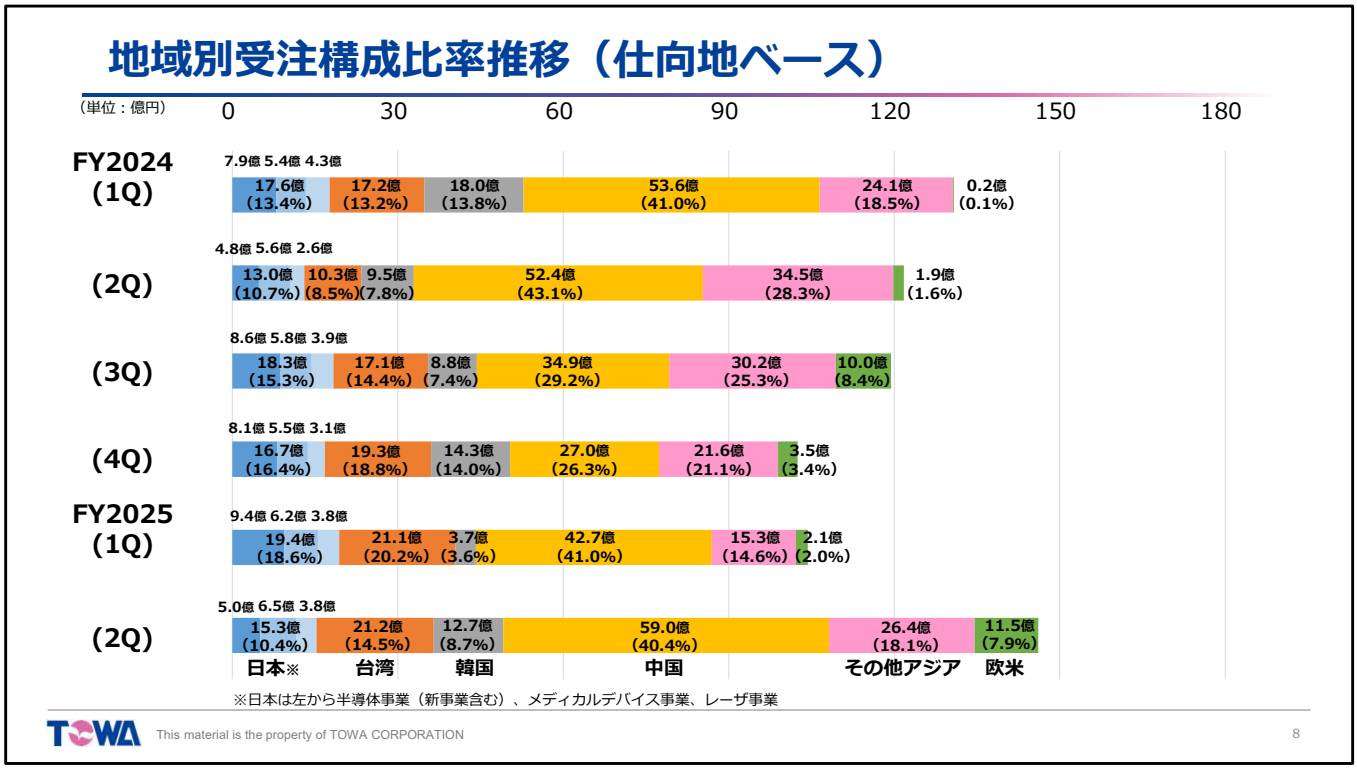
レーザ事業につきましては、主力製品であるレーザトリマ装置に対する設備投資が引き続き見送られたことなどの影響により、前期比33.0%減となりました。



こちらは四半期ごとの受注・売上高の推移です。

受注高につきましては、第4四半期、第1四半期で底打ちし、第2四半期はAI・データセンター向けやメモリ向けを中心に回復傾向が見られました。

売上高につきましては、第1四半期は米国関税政策の影響により、お客様の投資判断が慎重となったことにより大きく落ち込んだものの、
第2四半期は半導体設備投資が徐々に回復し、2024年3月期第4四半期に次ぐ高水準となりました。

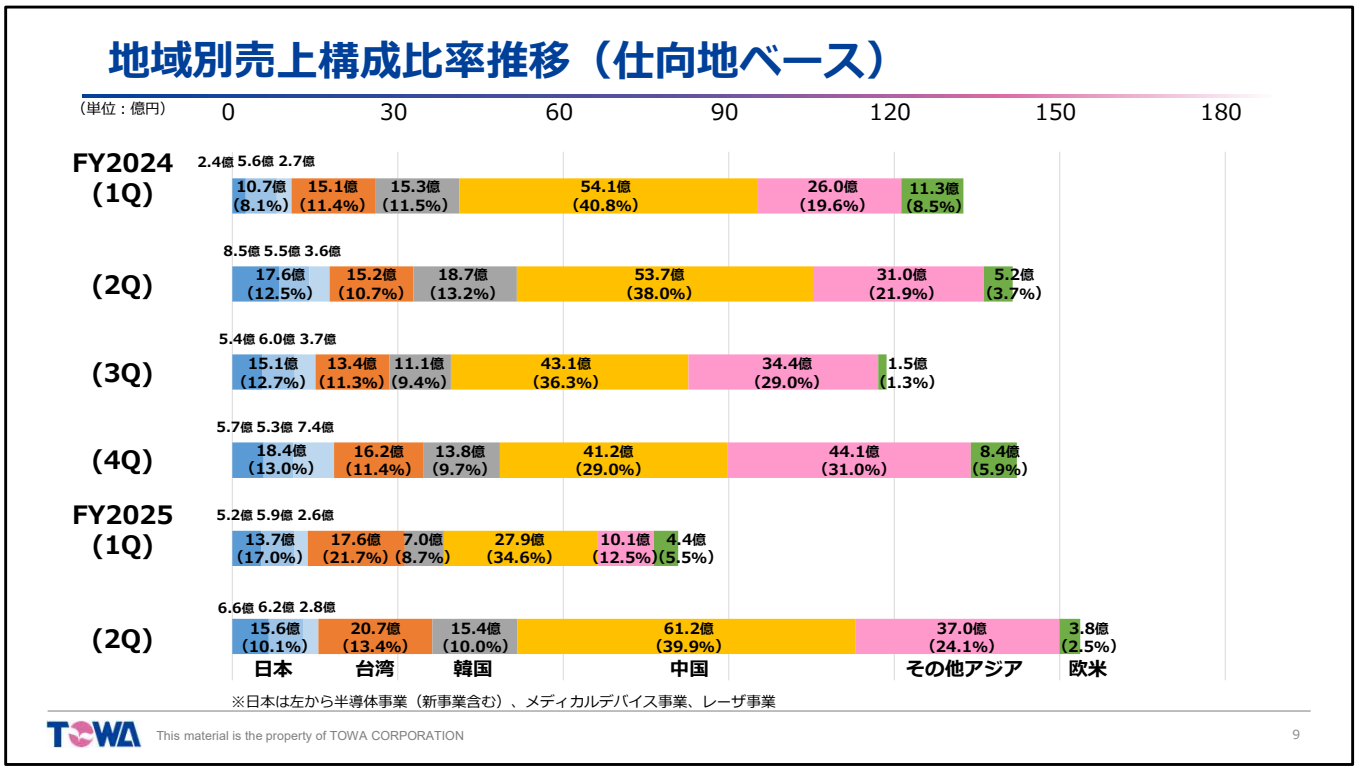


こちらは地域別の受注高です。金額は仕向地ベースで集計しています。

中国地域においては半導体内製化に向けた動きが継続しており、好調な受注が続いています。

その他アジア地域においては前第4半期、第1四半期は米国関税政策の影響で設備投資が落ち込んだものの、第2四半期は回復の傾向が見られました。

また、詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。



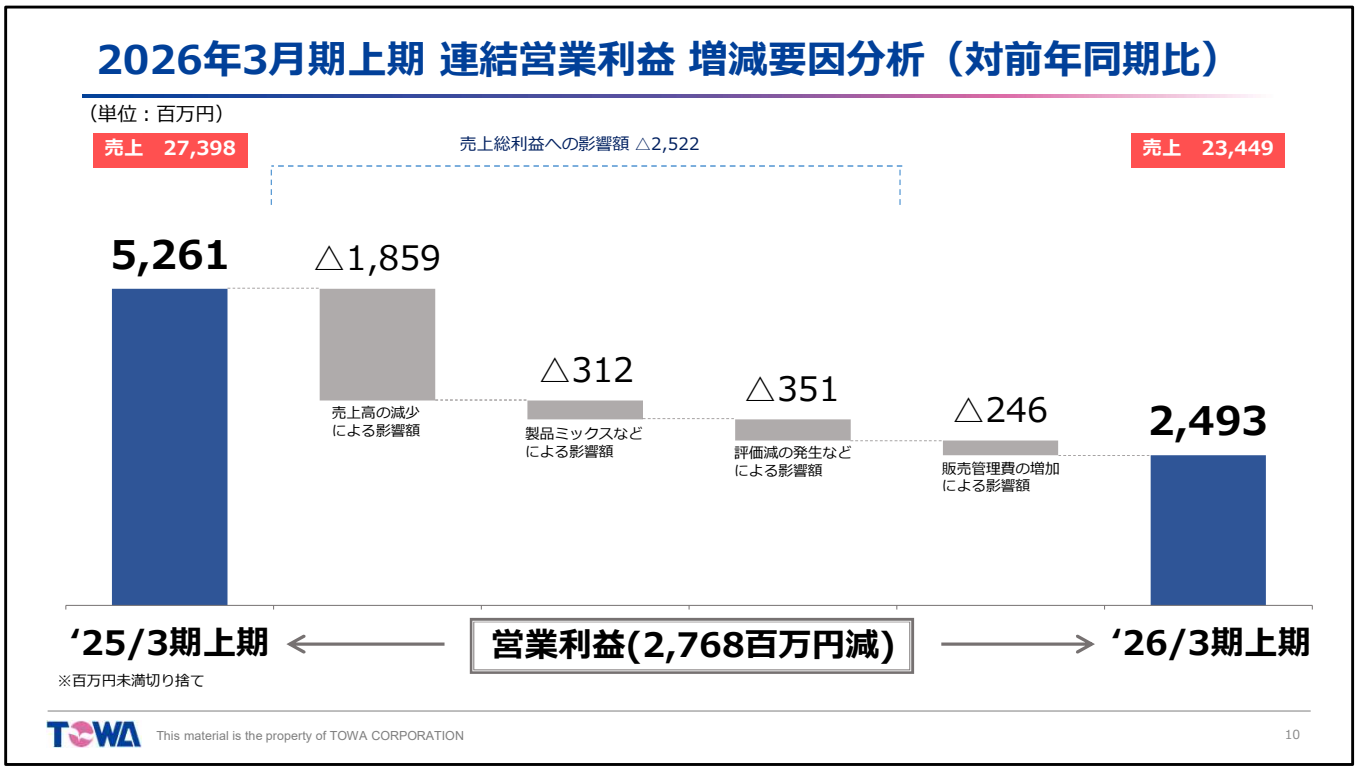
こちらは地域別の売上高です。金額は受注同様、仕向地ベースで集計しています。

中国地域は第1四半期からの受注回復を背景に第2四半期の売上高が大きく増加しました。

その他アジア地域は受注同様に、設備投資が徐々に回復してきており、第2四半期の売上高が増加しました。

台湾地域でも稼働率の改善や設備投資の回復により、徐々に売上高についても増加傾向となっています。

こちらも、詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。



こちらは、前期上期と今期上期の営業利益の増減要因分析です。

参考としてご覧ください。

主な説明内容

1．2026年3月期　上期実績

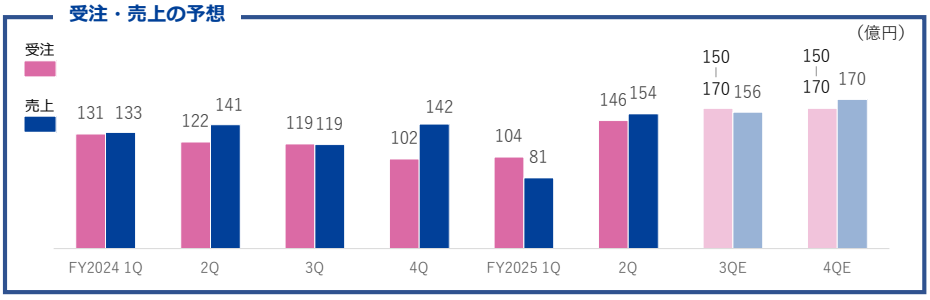
2．2026年3月期　通期予想

今後の市場見通し

受注
- ▶ **AI・データセンター向けが増加傾向であり、下期も引き続き牽引。**
- ▶ **開発用途向け装置など次世代市場をターゲットとした製品の受注も堅調。**

売上
- ▶ **米国の関税政策の影響により慎重姿勢が続いていた投資環境が改善し、下期にかけて売上高の増加を見込む。**

受注・売上の予想



受注高予想

3Q
150-170億円

4Q
150-170億円

損益予想

売上高	560.0億円
営業利益	98.0億円
経常利益	98.0億円
当期利益	68.6億円

こちらは、今後の市場見通しについてです。

受注につきましては、AI・データセンター向けの需要増加が続いており、下期も引き続き受注を牽引する見通しです。
また、開発用途向け装置など次世代市場向け製品の受注も堅調に推移しています。

売上高につきましては、米国の関税政策の影響で慎重だった投資環境が改善しつつあり、受注高の増加を背景に下期は増加を見込んでいます。

HBM関連情報アップデート

市場見通し

- **競争環境の変化を背景に、各社増産と次世代HBM量産投資を強化。**
- **クラウドサーバーの推論用途でもHBM採用が進む見込み。**
- **既存のHBM向けモールド装置の総出荷台数は約30台。※**
  用途と市場の拡大により、数年内に30-45台の追加投資が必要。※

※当社推定。総出荷台数は競合設備含む。

TOWA

- **HBM4でも顧客認証を取得。顧客基盤も拡大。**
- **狭ギャップMUF等、技術要求はさらに高度化。**
  高性能設備への入れ替え需要増に加え、参入障壁も高まる。

HBM関連の情報アップデートです。
AIやクラウドの急成長により、HBM需要は急速に拡大しています。同時に、HBMはAI時代の中核技術として、その市場環境も大きく変化しています。

・HBMはメモリメーカーにとって戦略的な製品です。各社は競争力を強化するため、増産体制を整え、次世代HBMの量産投資を加速しています。こうした動きが市場の成長を一層加速させています。

・また、HBMは主に生成AIの学習用途で使われてきましたが、今後はクラウドサーバーの推論用途でも採用が進む見込みです。学習用途は伸び続け、さらに推論用途が加わることで、需要は大きく拡大すると予想されます。

・当社の推定では、現在HBM生産用に出荷されたモールド装置は約30台です。しかし、競争環境の変化や用途と市場の拡大により、今後数年で30～45台程度の追加投資が必要になると見込んでいます。

・当社もこうした市場の変化に対応し、積極的に取り組んでおります。次世代HBMであるHBM4でも顧客認証を取得しました。また、顧客基盤も着実に拡大しています。

・さらに、狭ギャップMUFなど技術要求は一段と高度化しており、既存設備からの入れ替え需要も増える見込みです。この変化は、当社の競争力を一層強化する機会と捉えています。

2026年3月期 通期 連結業績予想

（単位：億円）

※期初予想から変更なし

	25/3期 通期実績	26/3期 予想 上期	26/3期 予想 下期	26/3期 予想 通期	増減額	前期比
売上高	534.7	234.4	325.5	560.0	+ 25.2	+ 4.7%
営業利益	88.8	24.9	73.0	98.0	+ 9.1	+ 10.4%
営業利益率	16.6%	10.6%	22.4%	17.5%	+ 0.9pt	-
経常利益	94.0	23.9	74.0	98.0	+ 3.9	+ 4.3%
当期純利益	81.2	18.4	50.1	68.6	▲ 12.6	▲ 15.5%

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

通期の業績予想についてです。

上期の業績は米国の関税政策の影響によるお客様の投資慎重姿勢から、前年同期比で減収減益となったものの、
通期予想は期初予想を据え置き、売上高・営業利益・経常利益については、前年同期比で増収増益を計画しています。

2026年3月期 セグメント別売上予想

（単位：億円）

変更あり

	25/3期 通期実績	26/3期 予想 上期	26/3期 予想 下期	26/3期 予想 通期	増減額	前期比
売上高	534.7	234.4	325.5	560.0	+ 25.2	+ 4.7%
半導体事業	395.3	173.3	250.0	423.3	+ 27.9	+ 7.1%
メディカルデバイス事業	22.6	12.2	12.4	24.6	+ 2.0	+ 8.8%
新事業	94.2	42.6	50.1	92.7	▲ 1.5	▲ 1.7%
レーザ事業	22.6	6.4	13.0	19.4	▲ 3.2	▲ 14.0%

TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

こちらは、セグメント別の業績予想です。

上期実績、受注残高、今後の見通し等を踏まえ、セグメント別の予想値を一部変更しました。
なお、合計売上高に変更はありません。

2026年3月期 配当計画

	2025/3期 実績	2026/3期 計画
配当	20.0円	20.0円

※ 中間配当は見送りとさせていただきました。

こちらは、今期の配当計画です。

2025年5月に発表しました計画から変更はありません。

ＴＯＷＡビジョン２０３２

「変革で世界の頂へ」

《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社　企画部
〒601-8105　京都市南区上鳥羽上調子町5番地　Tel：075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがいまして、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。